



平成16年6月期

決算短信（連結）

平成16年 8月17日

ULVAC

上場会社名 株式会社アルバック 上場取引所 東証一部
 コード番号 6728 本社所在都道府県 神奈川県

(URL <http://www.ulvac.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 中村 久三

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 氏名 常見 佳弘 TEL (0467) 89 - 2033

決算取締役会開催日 平成16年 8月17日

米国会計基準採用の有無 無

1. 平成16年 6月期の連結業績（平成15年 7月 1日～平成16年 6月30日）

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 6月期	157,851	23.8	8,476	78.9	7,266	104.7
15年 6月期	127,472	1.0	4,736	108.0	3,550	78.3

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率		総資本 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
16年 6月期	3,953	128.5	108	91	-	-	7.9	3.9	4.6			
15年 6月期	1,729	158.5	48	10	-	-	4.2	2.1	2.7			

(注) 持分法投資損益 16年 6月期 289百万円 15年 6月期 93百万円
 期中平均株式数（連結） 16年 6月期 33,844,672株 15年 6月期 32,428,156株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2) 連結財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭	
16年 6月期	200,645		58,145		29.0	1,506	15	
15年 6月期	173,949		41,951		24.1	1,288	44	

(注) 期末発行済株式数（連結） 16年 6月期 38,427,852株 15年 6月期 32,428,114株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
16年 6月期	9,559		12,172		4,357		16,635	
15年 6月期	14,135		8,906		881		15,124	

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 18社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 3社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） - 社（除外） - 社 持分法（新規） - 社（除外） - 社

2. 平成17年 6月期の連結業績予想（平成16年 7月 1日～平成17年 6月30日）

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
中間期	97,000		6,900		4,000	
通期	192,000		11,000		5,900	

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 153円53銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照して下さい。

1. 企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社30社、関連会社6社からなり、真空技術が利用されているさまざまな産業分野に多岐に渡る製品を生産財として提供している真空総合メーカーであります。

事業内容は、真空技術を基盤として、真空装置・機器やサービスを提供する真空関連事業と真空技術の周辺技術を基盤として、主に材料や表面解析等を提供するその他の事業に区分できます。

各々の事業区分ごとの主要製品は下表のとおりであります。

事業区分		主要製品
真空関連事業	ディスプレイおよび電子部品製造装置	スパッタリング装置、各種CVD装置、液晶注入装置、アニール装置、有機EL製造装置、真空蒸着装置、エッチング装置、レーザーアニール装置、インクジェットプリンティング装置
	半導体製造装置	スパッタリング装置、エッチング装置、イオン注入装置、レジストストリッピング装置、メタルCVD装置、減圧CVD装置、酸化炉、拡散炉
	コンポーネント	真空ポンプ（ドライポンプ、油回転ポンプ、メカニカルブースターポンプ、油拡散ポンプ、スパッタイオンポンプ、クライオポンプ、ターボ分子ポンプ）、各種真空計、ヘリウムリークディテクタ、質量分析計、表面形状測定装置、電源、成膜コントローラ
	その他	超高真空装置、CN-CVD/GN-CVD装置、各種CVD装置、超高真空排気装置、スパッタリング装置、MBE装置、真空溶解炉、真空熱処理炉、真空焼結炉、真空巻取蒸着装置、蒸着重合装置、真空ろう付炉、凍結真空乾燥装置、真空蒸留装置
その他の事業		スパッタリングターゲット材、蒸着材料、チタン・タンタル加工品、高融点活性金属（Ta、Nb、W、Mo）、超微粒子（ナノメタルインク）、オージェ電子分光分析装置、X線光電子分光分析装置、二次イオン質量分析装置、熱分析・熱物性測定装置、近赤外線イメージ炉応用機器、各種産業機械用駆動装置、DCS（分散形）制御装置

また、当企業集団の主要製品の概要は、次のとおりであります。

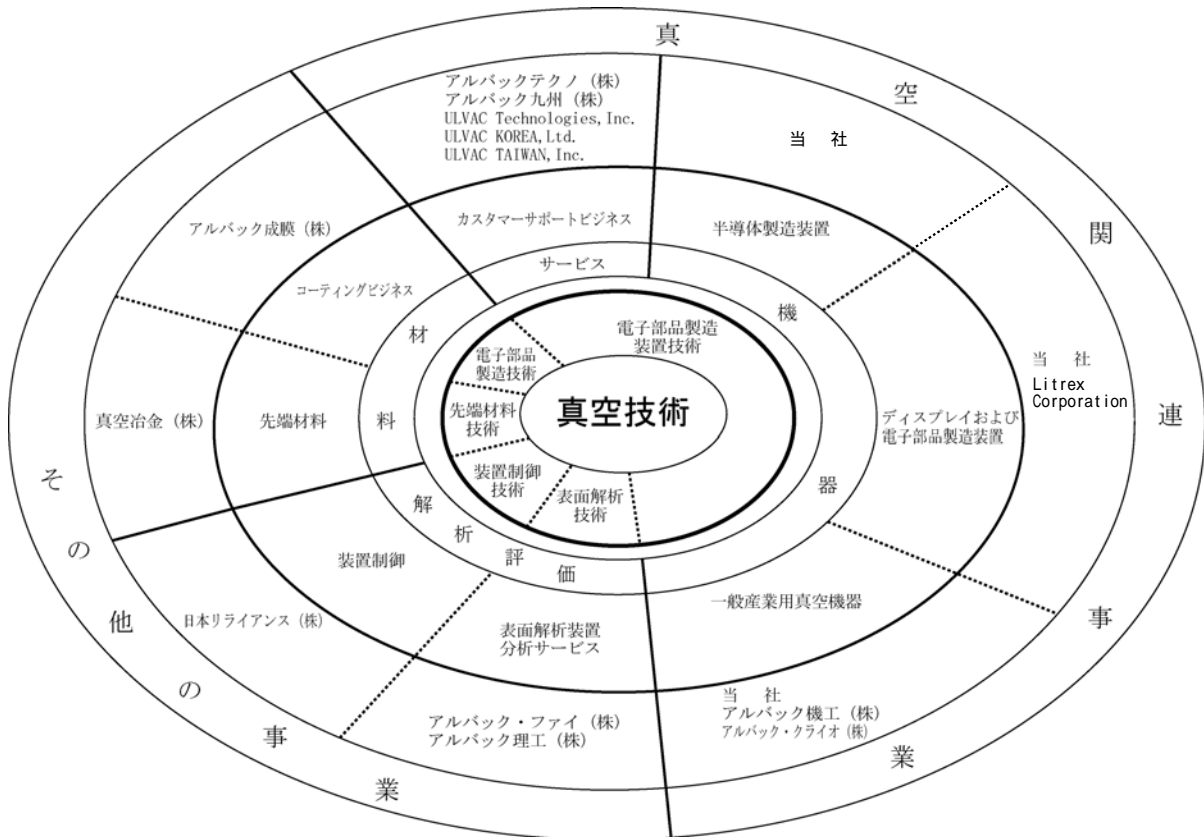
主要製品	概要
スパッタリング装置	高真空中で金属やシリサイドの円盤（ターゲット）に、高エネルギーのアルゴン原子をぶつけ、それに叩かれ飛び出してくる金属原子を付着させて成膜する装置。
CVD装置	つくる薄膜の種類に応じて原料をガス状態で供給し、下地膜の表面における化学触媒反応によって膜を堆積させる装置。
エッチング装置	真空中に被エッチング材料を入れ、その材料に合わせてエッチングガスを導入しプラズマ化し、エッチング種が被エッチング材料に吸着されると表面化学反応を起こし、エッチング生成物を排気除去する装置。
真空蒸着装置	真空中で特定の物質を熱し、そこから蒸発する原子や分子をより温度の低い面に凝縮させて、表面に膜を形成する装置。
真空熱処理炉	真空中で各種金属の焼入、ろう付、焼戻、容体化、時効、磁性処理等を行う装置。

以上のような装置により、携帯電話、パーソナルコンピューター、情報携帯端末（PDA）、太陽エネルギー利用機器、光通信デバイス、デジタル家電、自動車等の最終製品を構成するディスプレイおよび電子部品等が生み出されております。

当社グループは、お客様の生産品目に合せて、当社グループ全体で提供できる装置・機器、材料、解析評価、サービスなどを「アルバックソリューションズ」としてパッケージで提案し、グループ全体でシナジー効果を発揮しております。

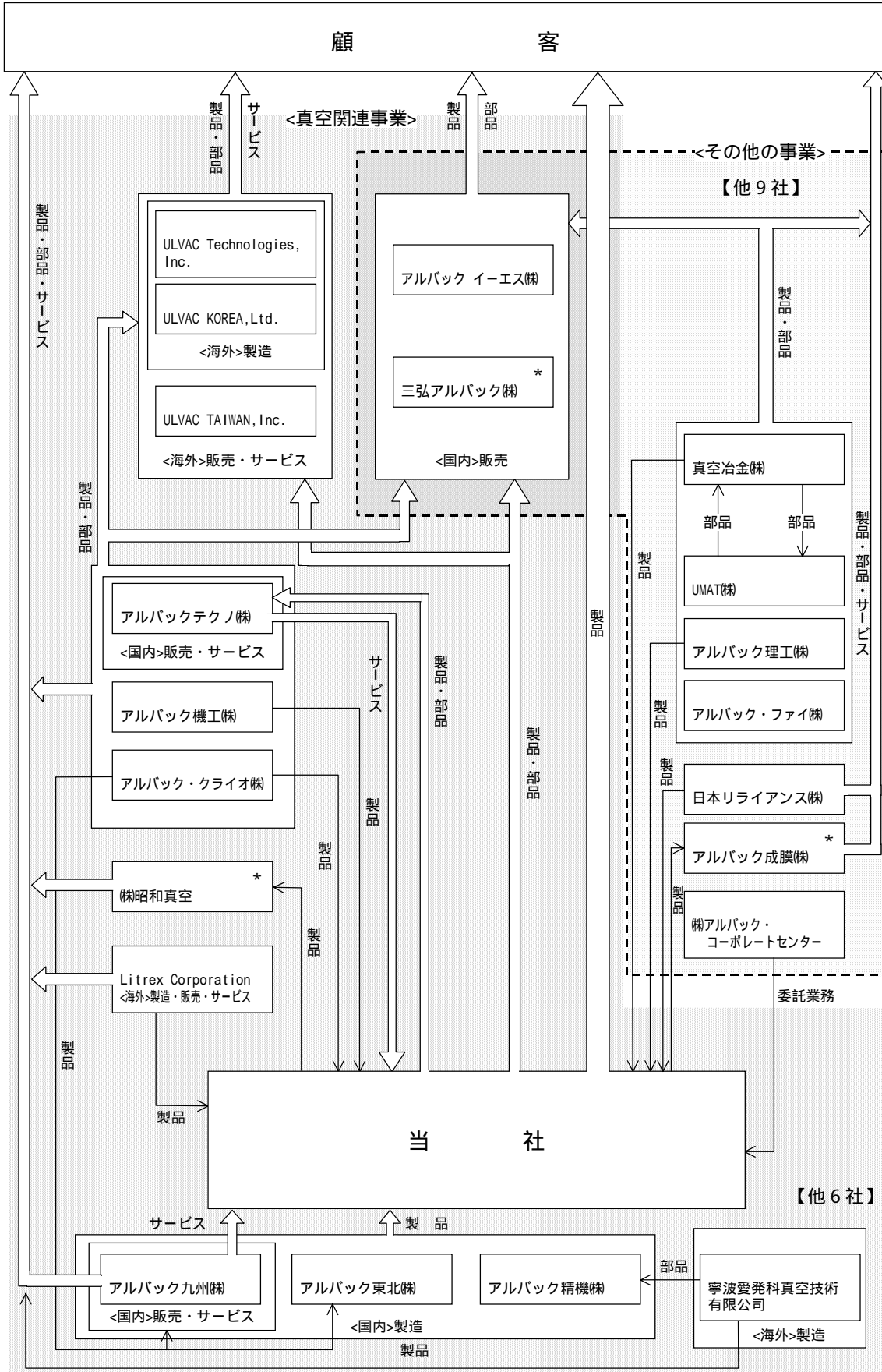
また、真空装置・機器とプロセス技術を組み合わせたお客様への提案もおこなっております。

アルバックソリューションズを構成する当社及び主な関係会社は、次のとおりであります。



アルバックソリューションズの一環として、カスタマーズサポート（CS）ソリューションズパッケージは、製造装置や機器を納入した後のアフターサービスをフィールドサービスの他、装置改良改善（CIP）活動、部品提供、成膜材料提供、装置部品再生、洗浄及び表面処理、分析サービス、中古機提供、オペレーティングリースなどの総合サービスを提供しております。

また、各々の事業区分ごとの事業の流れは以下の通りです。



() 連結子会社 (*) 持分法適用会社

2. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は下記5つの基本方針にもとづき、株主、投資家およびお客様の満足度の向上を図ることで企業価値を高めてまいります。

顧客満足度の増進

複雑化、高度化するお客様の課題に対し、技術、価格、納期、アフターサービスなどに迅速かつ柔軟に対応し、お客様の満足度の向上をめざします。

生産技術の革新

製造業の基本であるコスト競争力を高めるため、製造装置の標準化(モジュール化、ユニット化)を中心とした継続的な生産技術の革新をおこないます。

独創的な商品開発

競合他社が真似することのできない、最先端の独創技術を商品化し、開発型のソリューションを提供する企業をめざします。

自由闊達な組織

経営方針や情報が迅速に伝わる風通しのよい組織と企業風土を継続して形成します。

企業価値の向上

株主価値の向上にとどまらず、技術の総合利用を通じて産業と科学の発展に貢献することをめざします。

(2) 利益配分に関する基本方針

株主への利益配分を重要な政策と位置付け、1株当りの利益を高めるべく、収益力の向上に努め、その収益力・財政状況を基準に、企業体質強化および今後の事業展開に必要な内部留保の確保を考慮し、業績に応じた総合的な判断により適正な成果配分をおこなう方針です。

当期の配当は、業績拡大を受けて、前期比3円増配の1株10円とし、併せて平成16年4月20日の東京証券取引所市場第一部上場を記念して1株10円の記念配当を実施する予定であります。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方および方針

当社は、投資家の皆様が当社株式を求めやすい投資単位の金額に設定することを、株式の流動性を高め、より広範な投資家の皆様の参加を促す観点から重要と考えております。当社は、投資単位を50万円未満とすべく平成13年9月より、1単元の株式数を100株といたしました。今後も投資単位の引き下げにつきましては、株価の動向やマーケットの状況などを総合的に勘案し、検討していきたいと考えております。

(4) 目標とする経営指標

当社グループは、企業の成長、収益力向上、資金効率、株主価値の向上を重視しております。このため、経営指標として売上高、経常利益率およびROE(株主資本利益率)の向上を目標としております。

(5) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社グループの主要なお客様であるフラットパネルディスプレイ・電子部品業界および半導体業界におきましては、中期的に見ますと、ディスプレイやデジタル家電関連分野の成長は、周期的な変動をしながらも好調を維持すると予想されます。また、長期的には、ハイブリッドカーや二次電池、太陽電池などエネルギー・環境分野で新たな成長が始まると期待されます。地域的にみますと、今後中国が全世界の製造業を牽引すると予想されています。

製造装置業界におきましては、デフレ経済の影響による市場価格の下落が継続し、製造装置メーカー間での生き残りをかけた競争が激化し、長期的には、韓国や中国の製造装置メーカーが台頭する可能性があります。

このような環境において、以下の経営戦略を重点項目として掲げております。

コストダウン戦略

生産改革第2段階の2年目を迎え、開発や設計、調達・購買、製造など「エンジニアリングと製品作りの改革」を軌道に乗せ推進いたします。多品種少量生産品を対象とする標準化を中心としたコストダウン主体の生産改革の推進(生産改革第1段階)と、開発装置であっても完成度が高い製品作り(生産改革第2段階)をおこなうことで、価格競争力と収益性の向上をめざします。

受注拡大戦略

競合他社が真似できない独創的で最先端の新製品を開発し、お客様へご提供することで受注拡大をめざします。また、お客様の生産品目に合わせ、当社グループで提供できる製造装置、材料、分析機器、コンポーネント、サービスなどをパッケージとして提案する「アルバックソリューションズ」を活用し、シナジー効果による受注拡大をめざします。さらに、製造装置は、設備投資の増減の影響を受けやすいため装置稼働後の部品洗浄・表面処理やメンテナンス、材料供給などを「CS（カスタマーサポート）ソリューションパッケージ」として提案し、サービスを総合的に受注することで受注拡大と安定化をめざします。

財務戦略

生産改革が第2段階に進む中、引き続き収益力の向上、運転資金の圧縮などを通じて営業活動によるキャッシュ・フローの改善に一段と努力していきます。また、当社グループの企業価値増大に向け、平成16年4月の公募増資資金と営業活動によるキャッシュ・フローなどを、後述の 新商品開発戦略、同 グローバル化戦略の実現に向けて投資いたします。

新商品開発戦略

フラットパネルディスプレイなどの分野では、中期的には大型基板ディスプレイ（第7世代¹⁾以降の液晶ディスプレイやプラズマディスプレイパネル）製造装置、固体レーザーアニール装置、有機EL製造装置、長期的には大型基板用として期待のもてるインクジェットプリンティングなどの開発を推進していきます。

半導体分野におきましては、化合物半導体やMEMS²⁾などのデバイスに対応した製造装置の開発を強化します。

また、実装基板や光学薄膜など電子部品用製造装置、液晶ディスプレイ製造装置用大型ドライポンプなどの開発を推進していきます。

グローバル化戦略

成長する地域である韓国、台湾、中国を中心に引き続き事業の拡大をいたします。当社グループは、中国において製造装置やコンポーネントの本格的な生産を開始し、急成長する中国市場に対応した生産会社の設立や事業統括会社の設立を検討していきます。

韓国においては、第7世代以降の液晶ディスプレイ製造装置の生産工場を建設し、韓国市場での確固たる地位を築くことに注力いたします。

また、お客様満足度向上のため、台湾、中国、韓国、シンガポールなどの拠点を増強し、技術者のレベルアップなど、急成長するアジア地域でカスタマーサポート体制を強化します。

当社グループは、以上の重点戦略を踏まえ、真空技術をコア技術とし、製造装置や材料、サービスなど総合的なソリューションを提供するグループとして事業の拡大に努めます。

【用語説明】

1) 第7世代

世代とは、液晶ディスプレイ用のガラス基板（マザーガラス）のサイズを分類する総称。第7世代は1800×2200mmのサイズで世界最大。

2) MEMS

マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム（微小電子機械システム）の略で、半導体プロセス技術を用いて一つの基板上に電子と機械機構を融合させた微小デバイス。機械、光学、流体などの精密な機構部品やモジュールのマイクロ化や複合化を可能にして最終製品を特徴づける"要"の技術として大きな期待が寄せられている。

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

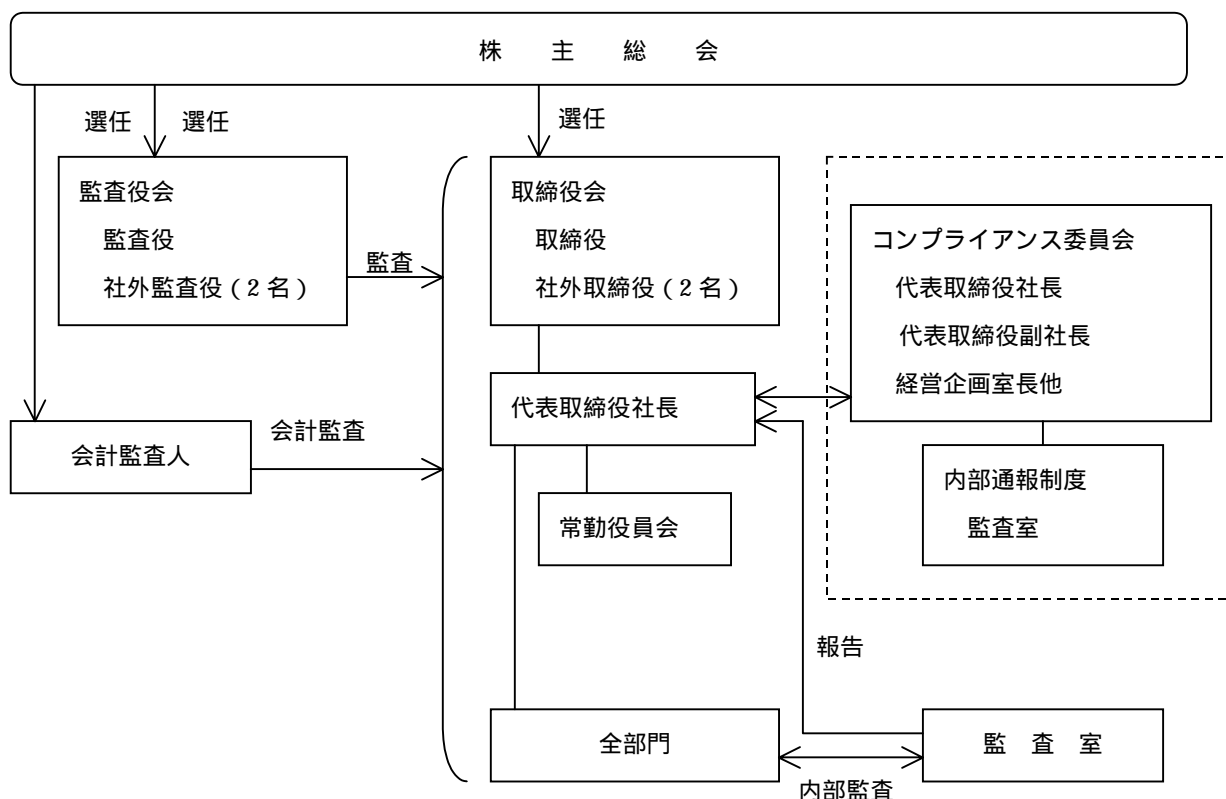
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを、社会ならびに株主の皆様に対する企業責任遂行のための最も重要な経営課題の一つとして認識しております。当社グループは、公正で透明性の高い企業経営をより一層推進していくために、18項目におよぶ「企業倫理行動基準」を制定いたしました。当社グループは、その遵守を通じて企業倫理の徹底を進め、当社グループの今後の発展と役員、社員全体の成長を目指すことを基本理念としております。

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役14名からなる経営体制、監査役4名からなる監査体制は、その意思決定や監督機能を十分に発揮し、迅速な経営判断がなされております。したがって、執行役員制の導入や委員会等設置会社への移行の予定はありませんが経営の監督機能確保の観点より、社外取締役（2名）、社外監査役（2名）体制をとっております。

内部統制につきましては、平成16年2月にグループ全体のリスクマネジメント規程を制定し、各種リスクに対する対処方法を明確に定め、推進しております。

また、当社グループは平成15年11月に「企業倫理行動基準」を制定すると同時に、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する教育、監査などを実施しております。また、グループ内におけるコンプライアンス違反について「内部通報制度」を設け、公正かつ適正に職務が遂行できるようにいたしました。会社の経営上の意思決定、執行および監督に係わる経営管理組織



会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係

当社の社外取締役木村光利氏は、日本生命相互会社常務取締役であり、同社は当社の筆頭株主であるとともに、当社の資金の借入先であります。また、社外取締役牧野正志氏は、松下電器産業株式会社役員であり、同社は当社の大株主であるとともに、当社との間において定常的な商取引をおこなっております。

当社の社外監査役佐藤恒雄氏は、弁護士であります。また、社外監査役長澤正人氏は元金融機関に在籍した有識者であります。

(7)環境に関する対応

当社は、平成13年に国際規格ISO14000の認証を取得し、順次グループ会社が取得しております。(グループで11社取得、平成16年7月現在) 当社グループは、地球環境の保全を人類共通の重要課題のひとつとしてとらえ、事業活動のあらゆる面で環境の保全に配慮し、住みよい地球と豊かな社会の発展に貢献することを、基本理念としております。

当社グループの環境に関する基本方針は以下の3つとなります。

- ・当社工場内における環境マネジメントを推進すること。
- ・当社製造装置を稼働しているお客様が省エネルギーを推進できること。
(例：ドライ式真空ポンプの消費電力が約1/3となるECO-SHOCKの商品化)
- ・当社製造装置から作り出される製品が省エネルギーに貢献できること。
(例：ハイブリッドカーや太陽電池などの製造装置の商品化)

また、環境に配慮した商品・サービスの提供において、有害物質全廃など調達段階における環境負荷の少ない資材の調達「グリーン調達」が不可欠となり、当社グループとしては、「グリーン調達基準書」を策定し、環境に配慮した資材調達活動を推進することとしております。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当連結会計年度の世界経済は、イラク情勢などの不安定要素がありましたが、米国では雇用環境の好転などにより好調な景気が持続しました。また、韓国、台湾や中国などのアジア地域でも設備投資が堅調に推移し回復基調が鮮明となりました。一方、わが国経済は、製造業全般で設備投資や輸出の増加にささえられ、堅調に推移いたしました。

このような状況において、当社グループの主要なお客様であるディスプレイや半導体関連の業界では、薄型テレビ（液晶テレビ、プラズマディスプレイ）やデジタルカメラ、DVD（デジタル多用途ディスク）、携帯電話などのデジタル家電市場が拡大し、韓国、台湾を中心に積極的な投資がおこなわれました。

当社グループはこのような経営環境に対処するため、独創的な新製品をタイミング良く市場投入しアルバックソリューションズの推進による積極的な受注活動をおこなってまいりました。また、お客様からの価格引き下げ要求による販売価格の下落に対し、生産改革第2段階の推進によりコストダウンを図るとともに、諸経費の削減を継続することで、固定費の圧縮を進めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績は受注高1,781億96百万円と前年同期に比べ304億29百万円（20.6%）増加し、売上高につきましては、1,578億51百万円と前年同期に比べ303億78百万円（23.8%）増加いたしました。当連結会計年度の損益につきましては、経常利益72億66百万円となりました。なお、当期純利益につきましては、39億53百万円となりました。

（真空関連事業）

ディスプレイおよび電子部品製造装置につきましては、韓国、台湾や日本において第5世代、第6世代液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどの設備投資が積極的に行われ、枚葉式スパッタリング装置「SMDシリーズ」、インライン式スパッタリング装置「SDPシリーズ」、インライン式真空蒸着装置「ECHシリーズ」の売上が好調を維持しました。

また、半導体製造装置はデジタル家電関連だけでなく、自動車関連向けパワーICやLEDなどの化合物半導体における設備投資がおこなわれ、スパッタリング装置「CERAUSシリーズ」、「ENTRONシリーズ」やエッチング装置「NEシリーズ」、「NLDシリーズ」などの売上が好調でした。

コンポーネントは、主に液晶ディスプレイ製造装置向けの大型ドライポンプやクライオポンプ、自動車部品業界家電業界向け真空ポンプなどの受注、売上が好調でした。

その結果、受注高につきましては、1,541億63百万円、受注残高756億8百万円、売上高につきましては、1,339億71百万円となりました。また、営業利益につきましては、77億38百万円となりました。

（その他の事業）

その他の事業につきましては、アルバックソリューションズを生かしたグループ一体となった積極的な拡販活動をおこない、液晶ディスプレイや半導体関連用スパッタリングターゲット材料や部品洗浄などの材料ビジネスと、ナノテクノロジー関連表面分析機器の受注、売上が堅調でした。

その結果、受注高につきましては、240億34百万円、受注残高64億40百万円、売上高につきましては、238億80百万円となりました。また、営業利益につきましては4億93百万円となりました。

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態

当期の概況

- ・ 当期末の資産、負債及び資本の状況

(単位；百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増 減
資 産	173,949	200,645	26,696
負 債	128,803	139,233	10,429
資 本	41,951	58,145	16,193

(資産)

急激な増収に伴い売掛金が11,134百万円、受取手形3,375百万円、受注残高増加に伴いたな卸資産が3,625百万円増加いたしました。本社工場等建設に伴い建物・構築物が3,343百万円増加し、また、グループ各社収益力増強のために増資を行い関係会社株式等は2,525百万円が増加いたしました。

(負債)

受注高の急激な伸長により、買掛金等債務残高が9,309百万円などが増加いたしました。

(資本)

上場時の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資により資本金が5,100百万円増加し、資本剰余金7,321百万円増加したほか、利益剰余金3,459百万円が増加いたしました。

・当期のキャッシュ・フローの状況

(単位；百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,135	9,559	4,577
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,906	12,172	3,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	881	4,357	5,239
現金及び現金同等物の期末残高	15,124	16,635	1,511
有利子負債残高	68,918	60,590	8,329

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前当期純利益は前期より増加しましたが、売上高の増加に伴う売上債権の増加により45億77百万円減少しました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有形固定資産や投資有価証券の取得による支出が増加したことにより、支出額が前期より32億65百万円増加いたしました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

上場時の公募増資およびオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資により124億21百万円の資金を調達することが出来ました。調達資金のうち50億円は当期及び翌期の研究開発のための資金に充当する予定でしたが、当期は29億12百万円使用しましたので、期末の現金及び預金として残した残金は翌期の研究開発のための資金に充当いたします。

また、調達の総額と研究開発のための資金の差額74億21百万円は予定通り借入金の返済に充当いたしました。

次期の見通し

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の回収強化などにより当期より増加することを見込んでおります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

将来の成長に向けてさらに積極的に開発投資、海外での事業展開のための投資に資金を投入するため、当期より増加することを見込んでおります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当期利益処分による配当金は、上場記念配当を加えて20円配当とする予定であります。

有利子負債残高は当期より若干増加することを見込んでおります。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

	平成 14 年 6 月期	平成 15 年 6 月期	平成 16 年 6 月期
株主資本比率 (%)	25.0	24.1	29.0
時価ベースの株主資本比率 (%)	-	-	70.7
債務償還年数 (年)	11.2	4.8	6.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ	6.7	15.7	9.5

(注)株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

平成15年6月期以前は、当社株式が非上場・非登録であったため記載しておりません。

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3)次期の見通し

当社グループの主要なお客様であるフラットパネルディスプレイ・電子部品業界および半導体業界での設備投資意欲は依然旺盛であると予想され、地域的には、韓国・台湾・中国と日本が好調を維持すると思われまます。このような市場環境において、お客様満足度向上に努め、独創的な商品開発をおこない、受注を拡大し、コストダウンを一層推進してまいります。

すなわち、生産改革第2段階を軌道に乗せ、標準装置から開発装置まで完成度の高い手離れの良い製品を製作することで、収益力の向上をめざします。また、大型基板ディスプレイ用装置だけでなく、ディスプレイ関連装置のラインナップを増やし、化合物半導体やMEMS、光学膜用製造装置など競争力のある開発をおこなっていきます。グローバル化としては、中国やロシアなどを中心に事業拡大のための基礎固めをおこなっていきます。また、韓国では、液晶ディスプレイ製造装置生産工場の建設をおこなう予定です。

次期の連結業績に関する見通し

(単位：億円)

	中間期	通期
連結売上高	970 (+37%)	1,920 (+22%)
真空関連事業	853 (+41%)	1,672 (+25%)
ディスプレイおよび 電子部品製造装置	560 (+58%)	1,066 (+33%)
半導体製造装置	130 (+34%)	249 (+24%)
コンポーネント	111 (+10%)	230 (+10%)
その他	52 (+1%)	127 (+2%)
その他事業	117 (+11%)	248 (+4%)
連結営業利益	70 (+181%)	118 (+39%)
連結経常利益	69 (+275%)	110 (+51%)
連結当期純利益	40 (+321%)	59 (+49%)

()内は前期比

当社グループは以上の重点戦略を踏まえ、真空技術をコア技術として、装置や材料、サービスなど総合的なソリューションを提供する企業集団として事業の拡大に努め、2005年6月期の連結売上高は1,920億円(前期比22%増)、連結経常利益は110億円(同51%増)、連結当期純利益は59億円(同49%増)を予想しております。

利益配分について

上記業績見通しおよび前述の利益配分に関する基本方針に則り、次期配当金につきましては安定的な配当を継続することとし、年間配当で1株当たり20円を予定しております。

(4)事業等のリスク

当社グループの業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因は主に以下のようなものがあります。

ディスプレイおよび半導体市場変動による影響

当社グループは、ディスプレイや半導体などの製造工程で使われる真空装置において、独自の技術開発をおこない、市場に投入することにより、シェアを獲得し成長してきました。同分野の売上は、連結売上高の60%以上を占めており、ディスプレイメーカーや半導体メーカーの需給のバランスにより、設備投資の大幅な縮小によって当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

研究開発による影響

当社グループは、積極的な研究開発投資を継続的にこなうことで、常に最先端技術を使用した新製品を市場に投入してきました。しかしながら、新技術を製品化する上で期待どおりの成果があがらない場合や市場への投入時期のずれ等により当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

価格競争による影響

当社グループの主要なお客様であるディスプレイ業界は、デジタル家電の拡大に伴い堅調に設備投資がおこなわれております。しかし、お客様からの強い販売価格の引き下げ要求が恒常化しているうえ、今後競合メーカーなどの参入による販売競争の激化や材料や購入品の価格高騰による原価上昇により、当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

海外売上高増加による影響

当社グループの海外売上高比率は39.6%となり、その大半が中国、韓国および台湾などのアジア地域となっております。為替リスクを回避するために円建て取引を原則としておりますが、こうした地域での販売に関して、円高時には価格競争力の面で海外メーカーに比べて不利となり、また一部外貨建て輸出も存在し、急激な為替変動によって価格の変動が生じて為替リスクとなることがあり、当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

品質に関する影響

当社グループは、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制を確立し、高いレベルのサービスを提供してきました。しかしながら、先端技術の製品を提供しているため、開発的な要素も多く、予期せぬ不良が発生して無償回収修理などにつながるような場合は、当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

知的財産権に関する影響

当社グループは、各種真空装置についての多数の特許を保有し、また積極的に権利獲得を目指しております。また、その製品に関わる特許調査もおこなっております。しかしながら、第三者からの予期せぬ特許侵害訴訟を提訴された場合に、当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

その他リスク

当社グループが事業遂行にあたり、同業他社および他業種企業と同様に世界および各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力により、当社グループ業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

- (注)この決算短信で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ・半導体・電子部品業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい産業です。また、世界経済、為替レートの変動、フラットパネル・半導体・電子部品の市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

4. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

区分	前連結会計年度 (平成15年6月30日)		当連結会計年度 (平成16年6月30日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	15,683		17,886	
2. 受取手形及び売掛金	51,878		66,387	
3. たな卸資産	43,587		47,213	
4. 繰延税金資産	2,776		2,956	
5. その他	2,782		2,653	
6. 貸倒引当金	334		236	
合計	116,375	66.9	136,859	68.2
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物及び構築物	32,878		37,144	
減価償却累計額	15,490	17,387	16,413	20,731
2. 機械装置及び運搬具	31,305		33,332	
減価償却累計額	17,997	13,307	19,176	14,156
3. 工具器具及び備品	8,900		9,456	
減価償却累計額	7,264	1,636	7,582	1,874
4. 土地		7,426		7,369
5. 建設仮勘定		4,489		2,218
計	44,248	25.4	46,348	23.1
(2) 無形固定資産				
1. 連結調整勘定	186		1,703	
2. その他	667		695	
計	853	0.5	2,399	1.2
(3) 投資その他の資産				
1. 投資有価証券	6,775		8,464	
2. 繰延税金資産	2,605		2,876	
3. 差入保証金	1,244		1,252	

区分	前連結会計年度 (平成15年6月30日)		当連結会計年度 (平成16年6月30日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
4. その他	1,862		2,523	
5. 貸倒引当金	18		77	
計	12,469	7.2	15,039	7.5
合計	57,572	33.1	63,785	31.8
繰延資産				
1. 社債発行差金	1		1	
合計	1	0.0	1	0.0
資産合計	173,949	100.0	200,645	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	35,536		50,153	
2. 短期借入金	42,691		34,847	
3. 一年以内償還予定社債	-		500	
4. 未払法人税等	1,382		2,600	
5. 繰延税金負債	0		3	
6. 賞与引当金	967		1,079	
7. 製品保証引当金	1,637		2,320	
8. その他	12,042		12,809	
合計	94,257	54.1	104,312	52.0
固定負債				
1. 社債	3,000		2,700	
2. 長期借入金	23,449		23,161	
3. 退職給付引当金	6,851		7,864	
4. 役員退職慰労引当金	995		906	
5. その他	248		290	
合計	34,545	19.9	34,921	17.4
負債合計	128,803	74.0	139,233	69.4

区分	前連結会計年度 (平成15年6月30日)		当連結会計年度 (平成16年6月30日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(少数株主持分)				
少数株主持分	3,194	1.9	3,268	1.6
(資本の部)				
資本金	3,850	2.2	8,950	4.5
資本剰余金	2,859	1.6	10,181	5.1
利益剰余金	35,420	20.3	38,880	19.4
その他有価証券評価差額金	13	0.0	666	0.3
為替換算調整勘定	165	0.0	531	0.3
自己株式	0	0.0	1	0.0
資本合計	41,951	24.1	58,145	29.0
負債、少数株主持分及び資本合計	173,949	100.0	200,645	100.0

(2) 連結損益計算書

区分	前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)			
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)		
売上高		127,472	100.0	157,851	100.0	
売上原価		103,364	81.1	127,854	81.0	
売上総利益		24,108	18.9	29,996	19.0	
販売費及び一般管理費						
1. 販売費	8,075			8,460		
2. 一般管理費	11,296	19,371	15.2	13,060	21,521	13.6
営業利益		4,736	3.7	8,476	5.4	
営業外収益						
1. 受取利息	44			36		
2. 受取配当金	90			131		
3. 受取手数料	272			257		
4. 受取賃貸料	66			89		
5. 持分法による投資利益	93			289		
6. 為替差益	4			57		
7. その他	382	955	0.7	499	1,357	0.8
営業外費用						
1. 支払利息	931			978		
2. たな卸資産除却損	135			458		
3. 賃貸資産経費	169			157		
4. たな卸資産評価損	648			749		
5. その他	257	2,142	1.7	225	2,567	1.6
経常利益		3,550	2.7	7,266	4.6	
特別利益						
1. 固定資産売却益	0			0		
2. 貸倒引当金戻入額	153			143		
3. 投資有価証券売却益	188			19		
4. 補助金等受入益	140			162		
5. 受取保険金	44			-		
6. その他	76	603	0.4	69	394	0.2

区分	前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)			当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)		
	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
特別損失						
1. 固定資産除却損	61			509		
2. 投資有価証券評価損	686			-		
3. 関係会社出資金評価損	-			113		
3. その他	127	874	0.6	173	796	0.5
税金等調整前当期純利益		3,278	2.5		6,864	4.3
法人税、住民税及び事業税	1,869			3,597		
法人税等調整額	726	1,142	0.9	909	2,688	1.7
少数株主利益		406	0.3		222	0.1
当期純利益		1,729	1.3		3,953	2.5

(3) 連結剰余金計算書

区分	前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)		当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)	
	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		2,859		2,859
資本剰余金増加高				
1. 増資による新株の発行	-	-	7,321	7,321
資本剰余金期末残高		2,859		10,181
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		33,738		35,420
利益剰余金増加高				
1. 当期純利益	1,729		3,953	
2. 持分法適用会社の減少に伴う増加高	248	1,978	-	3,953
利益剰余金減少高				
1. 配当金	226		227	
2. 役員賞与 (うち監査役賞与)	69 (0)	296	266 (12)	493
利益剰余金期末残高		35,420		38,880

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,278	6,864
減価償却費	4,645	5,195
貸倒引当金の減少額	52	37
退職給付引当金の増加額	663	1,018
役員退職慰労引当金の減少額	94	90
製品保証引当金の増加額	318	635
固定資産除却損	121	549
投資有価証券評価損	686	-
関係会社出資金評価損	-	113
投資有価証券売却益	188	19
受取利息及び受取配当金	134	166
支払利息	931	978
補助金等受入益	140	162
固定資産圧縮損	-	59
持分法による投資利益	93	289
売上債権の減少額(増加額)	5,638	14,648
たな卸資産の増加額	9,122	3,457
仕入債務の増加額	10,713	14,767
前受金の減少額	1,794	120
未払消費税等の増加額(減少額)	443	110
その他	1,360	1,436
小計	16,293	12,735
法人税等の支払額	1,428	2,370
利息及び配当金の受取額	170	200
利息の支払額	900	1,006
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,135	9,559
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	338	761
定期預金の払戻による収入	230	64
有価証券の償還による収入	19	-

区分	前連結会計年度 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)	当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
投資有価証券の売却による収入	122	100
投資有価証券の取得による支出	492	560
連結子会社株式の取得による支出	1,668	62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	1,873
貸付による支出	38	52
貸付金の回収による収入	351	77
有形及び無形固定資産の取得による支出	7,753	9,275
有形固定資産の売却による収入	1,605	994
補助金による収入	140	151
長期前払費用の取得による支出	1,049	144
その他	37	830
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,906	12,172
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増加額(純減少額)	118	9,429
長期借入れによる収入	9,590	12,077
長期借入金の返済による支出	10,391	10,623
社債の発行による収入	-	200
株式の発行による収入	-	12,421
少数株主への株式の発行による収入	87	-
配当金の支払額	226	226
少数株主への配当金の支払額	60	61
自己株式の取得による支出	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	881	4,357
現金及び現金同等物に係る換算差額	67	233
現金及び現金同等物の増加額	4,279	1,511
現金及び現金同等物の期首残高	10,389	15,124
合併による現金及び現金同等物の増加額	454	-
現金及び現金同等物の期末残高	15,124	16,635

(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
1. 連結の範囲に関する事項	<p>(1) 連結子会社の数 18社 連結子会社名は次のとおりです。 真空冶金(株) アルバック理工(株) アルバックテクノ(株) アルバック九州(株) アルバック東北(株) アルバック精機(株) (株)アルバック・コーポレートセンター ULVAC Technologies, Inc. アルバック機工(株) UMAT(株) 日本リライアンス(株) アルバック イーエス(株) アルバック・クライオ(株) アルバック・ファイ(株) ULVAC KOREA, Ltd. ULVAC TAIWAN, Inc. 寧波愛発科真空技術有限公司 Litrex Corporation なお、Litrex Corporationについては、当連結会計年度に株式を取得し子会社となったため、連結の範囲に加えております。</p> <p>(2) 非連結子会社の数 12社 非連結子会社名は次のとおりです。 ULVAC G.m.b.H. ULVAC System Control TAIWAN, Ltd. アルバックエルダー(株) VMC Europe G.m.b.H. VMC TAIWAN Co., Ltd (株)RAS 日真制御(株) 愛発科真空技術(上海)有限公司 ULVAC SINGAPORE PTE LTD タイゴールド(株) Physical Electronics USA, Inc. 愛発科真空技術(蘇州)有限公司</p>

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
	<p>(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由</p> <p>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益、利益剰余金等の観点からみても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。</p>
2. 持分法の適用に関する事項	<p>(1) 持分法適用の非連結子会社数 - 社</p> <p>(2) 持分法適用の関連会社数 3 社</p> <p>アルバック成膜(株) 株昭和真空 三弘アルバック(株)</p> <p>(3) 持分法を適用していない非連結子会社(12社)及び関連会社(3社)については、いずれも連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p>

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
<p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項</p>	<p>連結子会社のうち、日本リライアンス㈱、ULVAC TAIWAN, Inc.、ULVAC KOREA, Ltd.、寧波愛発科真空技術有限公司、Litrex Corporationの決算日は12月31日であり、真空冶金㈱、UMAT㈱、㈱アルバック・コーポレートセンター、アルバック機工㈱、及びULVAC Technologies, Inc.の決算日は3月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、12月31日が決算日の連結子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、3月31日が決算日の連結子会社については、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。</p>
<p>4. 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p>	<p>たな卸資産...主として個別法による原価法によっております。</p> <p>有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>デリバティブ 時価法</p>

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
(2) 重要な減価償却資産 の減価償却の方法	<p>有形固定資産...定率法のほか、 当社の研究開発部門・ 富士裾野工場及び賃貸 用有形固定資産につい ては、定額法を採用し ております。</p> <p>ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建 物（建物附属設備を除 く）については、定額 法を採用しておりま す。</p> <p>なお、取得価額が10万 円以上20万円未満の資 産については、3年間 で均等償却する方法を 採用しております。</p> <p>また、耐用年数につい ては、主として、法人 税法に規定する方法と 同一の基準によってお ります。</p> <p>無形固定資産...定額法</p> <p>ただし、ソフトウェア （自社利用分）につい ては、社内における利 用可能期間（5年）に 基づく定額法を採用し ております。</p> <p>また、耐用年数につい ては、主として、法人 税法に規定する方法と 同一の基準によってお ります。</p>

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
<p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>(4) 重要な引当金の計上 基準</p>	<p>社債発行差金...商法の規定による社債償還期限で均等償却をしております。</p> <p>新株発行費...支出時に全額費用処理しております。</p> <p>貸倒引当金...債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金...従業員に支給する賞与の当期負担分として、支給対象期間に基づく当期対応分の支給見込額を計上しております。</p> <p>製品保証引当金...販売された製品の保証に伴う費用の支出に備えるため計上したもので、過去の発生実績率に基づいて計上しております。</p>

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
<p>(5) 重要な外貨建の資産 又は負債の本邦通貨へ の換算の基準</p> <p>(6) 重要なリース取引の 処理方法</p> <p>(7) その他連結財務諸表 作成のための重要な事 項</p>	<p>退職給付引当金...従業員の退職給 付に備えるため、当連結会 計年度末における退職給付 債務及び年金資産の見込額 に基づき、当連結会計年度 末において発生していると 認められる額を計上してお ります。</p> <p>なお、会計基準変更時差異 (3,425百万円)については 10年による按分額を費用処 理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その 発生時の従業員の平均残存 勤務期間以内の一定の年数 (10年)による定額法によ り翌連結会計年度から費用 処理することとしておりま す。</p> <p>役員退職慰労引当金...役員の退職 時に支給される退職慰労金 の支払に備えるため設定し たもので、計上額は内規に よる期末要支給額の100%額 であります。</p> <p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直 物為替相場により円貨に換算し、換算 差額は損益として処理しております。</p> <p>なお、在外子会社等の資産及び負債、 収益及び費用は、決算日の直物為替相 場により円貨に換算しており、換算差 額は少数株式持分及び資本の部におけ る為替換算調整勘定に含めて計上して おります。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転す ると認められるもの以外のファイナン ス・リース取引については、通常の賃 貸借取引に係る方法に準じた会計処理 によっております。</p> <p>消費税等の会計処理...税抜方式を 採用しております。</p>

項 目	当連結会計年度 (自 平成15年 7月 1日 至 平成16年 6月30日)
5．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項	連結子会社の資産及び負債の評価方法については、全面時価評価法によっております。
6．連結調整勘定の償却に関する事項	連結調整勘定は5年間及び8年間の償却期間で定額法により償却しております。
7．利益処分項目等の取扱いに関する事項	連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。
8．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	手許現金、要求払預金及び随時引き出し可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。

(6)セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

科目	前連結会計年度（自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日）				
	真空関連事業 （百万円）	その他の事業 （百万円）	計 （百万円）	消去又は全社 （百万円）	連結 （百万円）
・売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	105,311	22,161	127,472	-	127,472
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	124	3,018	3,143	(3,143)	-
計	105,435	25,180	130,615	(3,143)	127,472
営業費用	101,998	24,003	126,001	(3,265)	122,735
営業利益又は営業損失()	3,436	1,177	4,614	122	4,736

科目	当連結会計年度（自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日）				
	真空関連事業 （百万円）	その他の事業 （百万円）	計 （百万円）	消去又は全社 （百万円）	連結 （百万円）
・売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	133,971	23,880	157,851	-	157,851
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	103	3,731	3,835	(3,835)	-
計	134,074	27,611	161,685	(3,835)	157,851
営業費用	126,336	27,117	153,453	(4,078)	149,375
営業利益又は営業損失()	7,738	493	8,232	244	8,476

(注) 1. 事業区分は、主要製品の区分によっております。

2. 各事業区分の主要製品は、企業集団の状況の記載と同様であります。

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

海外売上高

	前連結会計年度（自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日）				
	アジア	北アメリカ	ヨーロッパ	その他の地域	計
海外売上高（百万円）	46,342	2,958	378	508	50,187
連結売上高（百万円）					127,472
連結売上高に占める海外売上高の割合（％）	36.3	2.3	0.3	0.4	39.3

	当連結会計年度（自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日）				
	アジア	北アメリカ	ヨーロッパ	その他の地域	計
海外売上高（百万円）	57,778	3,911	760	54	62,503
連結売上高（百万円）					157,851
連結売上高に占める海外売上高の割合（％）	36.6	2.5	0.5	0.0	39.6

（注）1．国又は地域の区分の方法.....地理的近接度によっております。

2．各区分に属する主な国又は地域

- (1) アジア 中国・韓国・台湾
- (2) 北アメリカ アメリカ・カナダ
- (3) ヨーロッパ イギリス・オランダ
- (4) その他の地域 オーストラリア

3．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)	
	生産高	前年同期比
真空関連事業	152,512	130.8%
その他の事業	23,880	107.8
合計	176,392	127.1

(注) 1. 金額は、販売価格をもって表示しております。

2. 受注生産品は、当連結会計年度に販売した製品を販売価格をもって表示しております。

3. 消費税等は含んでおりません。

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)			
	受注高	前年同期比	受注残高	前年同期比
真空関連事業	154,163	122.6%	75,608	136.8%
その他の事業	24,034	108.9	6,440	102.4
合計	178,196	120.6	82,049	133.3

(注) 消費税等は含んでおりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)	
	販売高	前年同期比
真空関連事業	133,971	127.2%
その他の事業	23,880	107.8
合計	157,851	123.8

(注) 1. 消費税等は含んでおりません。

2. 真空関連事業の主な品目別販売実績および当該販売実績に対する割合

(単位：百万円)

品目	前連結会計年度		当連結会計年度	
	販売高	割合	販売高	割合
ディスプレイおよび電子部品製造装置	58,126	55.2%	80,421	60.0%
半導体製造装置	18,135	17.2	20,138	15.0
コンポーネント	18,085	17.2	20,976	15.7
その他	10,963	10.4	12,436	9.3
計	105,311	100.0	133,971	100.0

(注) コンポーネントは真空ポンプ、真空計測器、部品・電源・ソフトであります。